

## 无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事

### 关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司2023年度对外担保情况进行审慎核查后，做出如下专项说明及独立意见：

1. 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.63%，为对全资子公司无锡安趋电子有限公司和苏州博创集成电路设计有限公司提供的担保，无逾期担保情况。上述对全资子公司的担保均已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序。

2. 除上述情况外，公司及控股子公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

3. 2023年度公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，报告期内存在的公司对全资子公司的担保符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

---

时龙兴

2024 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

---

胡义东

2024 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事签字：

---

邬成忠

2024 年 4 月 12 日